

2024-2030年中国化学机械 抛光（CMP）技术行业前景展望与投资策略报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国化学机械抛光（CMP）技术行业前景展望与投资策略报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/412330.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

化学机械抛光（Chemical Mechanical Polishing，CMP）技术被誉为是当今时代能实现集成电路（IC）制造中晶圆表面全局平坦化的目前唯一技术，化学机械抛光的效果直接影响到芯片最终的质量和成品率。CMP系统主要由抛光设备、抛光液和抛光垫三个部分组成。

2021年全球CMP设备市场空间约为26亿美元，中国大陆7.5亿美元，随着先进制程发展，CMP步骤从65nm的12道步骤增加到7nm的30道，并会增加新材料的去除工艺。国产替代空间广阔，AMAT和荏原在全球CMP设备中占比超过90%，华海清科为唯一量产CMP设备的国内厂商，2018-2021年公司在国内CMP市场的占有率分别为1.1%、6.2%、12.6%、16.5%，国产化率持续快速提升，部分产线2021年根据中标台数国产化率超过40%。

需求和供给两方面动力将推动中国半导体CMP抛光材料市场的发展。在需求方面，集成电路生产技术的提升使CMP抛光材料行业市场扩容。在供给方面，半导体CMP抛光材料是高价值、高消耗材料，资本进入该领域动力大，推动中国半导体CMP抛光材料供应企业数量增加。中国政策对半导体行业发展的鼓励和国际政策对半导体材料的出口管制促进中国半导体CMP抛光材料行业发展。一方面，中国对半导体产业高度重视，出台各项政策并成立国家产业基金大力扶持；另一方面，作为半导体产业中的关键材料，国际政府对CMP抛光材料进行出口管制，利好中国CMP抛光材料行业发展。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国化学机械抛光（CMP）技术行业前景展望与投资策略报告》共九章。首先介绍了CMP技术的概念及研究情况等，接着分析了国内CMP技术的发展环境，然后分析了CMP抛光材料行业和抛光设备行业的运行情况，并分析了我国CMP技术主要应用领域集成电路制造行业的发展情况。随后，报告对国内外CMP技术行业重点企业及项目投资案例做了介绍分析，最后重点分析了行业的发展趋势。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、中国半导体行业协会、海关总署、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心、中国半导体行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对CMP技术行业有个系统深入的了解、或者想投资CMP技术行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录：

第一章 化学机械抛光（CMP）技术相关概述

1.1 CMP技术概述

1.1.1 CMP技术概念

- 1.1.2 CMP工作原理
- 1.1.3 CMP反应原理
- 1.2 CMP技术研究情况
 - 1.2.1 CMP设备
 - 1.2.2 CMP抛光垫
 - 1.2.3 CMP抛光液磨粒
 - 1.2.4 CMP抛光液氧化剂
 - 1.2.5 CMP抛光液其它添加剂

第二章 2021-2023年中国化学机械抛光（CMP）技术发展环境

- 2.1 政策环境
 - 2.1.1 行业相关支持政策
 - 2.1.2 应用示范指导目录
- 2.2 经济环境
 - 2.2.1 全球经济形势
 - 2.2.2 国内经济运行
 - 2.2.3 工业经济运行
 - 2.2.4 宏观经济展望
- 2.3 社会环境
 - 2.3.1 人口结构状况
 - 2.3.2 居民收入水平
 - 2.3.3 居民消费结构

第三章 2021-2023年中国CMP抛光材料行业发展状况

- 3.1 半导体材料行业发展分析
 - 3.1.1 半导体材料主要细分产品
 - 3.1.2 半导体材料行业发展历程
 - 3.1.3 半导体材料行业发展规模
 - 3.1.4 半导体材料市场构成分析
 - 3.1.5 半导体材料行业发展措施
 - 3.1.6 半导体材料行业发展前景
- 3.2 CMP抛光材料行业概述

- 3.2.1 抛光材料组成
- 3.2.2 抛光材料应用
- 3.2.3 行业技术要求
- 3.2.4 行业产业链全景
- 3.3 CMP抛光材料市场发展分析
 - 3.3.1 全球市场发展
 - 3.3.2 国内发展历程
 - 3.3.3 国内市场发展
 - 3.3.4 行业壁垒分析
- 3.4 CMP抛光液市场发展分析
 - 3.4.1 CMP抛光液主要成分
 - 3.4.2 CMP抛光液主要类型
 - 3.4.3 CMP抛光液行业发展规模
 - 3.4.4 CMP抛光液行业竞争格局
 - 3.4.5 CMP抛光液行业发展机遇
 - 3.4.6 CMP抛光液行业进入壁垒
- 3.5 CMP抛光垫市场发展分析
 - 3.5.1 CMP抛光垫主要类别
 - 3.5.2 CMP抛光垫主要作用
 - 3.5.3 CMP抛光垫市场需求分析
 - 3.5.4 CMP抛光垫行业市场规模
 - 3.5.5 CMP抛光垫行业竞争格局
 - 3.5.6 CMP抛光垫行业驱动因素
 - 3.5.7 CMP抛光垫国产替代空间
- 3.6 CMP抛光材料行业制约因素
 - 3.6.1 技术封锁阻碍发展
 - 3.6.2 下游认证壁垒高
 - 3.6.3 高端人才紧缺限制

第四章 2021-2023年中国CMP设备行业发展状况

- 4.1 半导体设备行业发展情况
 - 4.1.1 半导体设备概述

- 4.1.2 半导体设备发展规模
- 4.1.3 半导体设备市场需求
- 4.1.4 半导体设备行业格局
- 4.1.5 半导体设备国产化分析
- 4.1.6 半导体设备行业投资状况
- 4.2 全球CMP设备行业发展情况
 - 4.2.1 全球CMP设备市场分布
 - 4.2.2 全球CMP设备竞争格局
 - 4.2.3 全球CMP设备市场规模
- 4.3 中国CMP设备行业发展情况
 - 4.3.1 CMP设备应用场景
 - 4.3.2 CMP设备产品类型
 - 4.3.3 CMP设备市场规模
 - 4.3.4 CMP设备市场分布
 - 4.3.5 CMP设备市场集中度
 - 4.3.6 CMP设备行业面临挑战
- 4.4 CMP设备行业投资风险
 - 4.4.1 市场竞争风险
 - 4.4.2 技术创新风险
 - 4.4.3 技术迭代风险
 - 4.4.4 客户集中风险
 - 4.4.5 政策变动风险

第五章 2021-2023年化学机械抛光（CMP）技术应用领域发展分析——集成电路制造行业

- 5.1 集成电路制造行业概述
 - 5.1.1 行业发展历程
 - 5.1.2 企业经营模式
 - 5.1.3 行业技术发展
- 5.2 全球集成电路制造业发展分析
 - 5.2.1 全球集成电路产业态势
 - 5.2.2 全球集成电路市场规模

- 5.2.3 全球集成电路市场份额
- 5.2.4 全球晶圆制造产能分析
- 5.3 中国集成电路制造业发展分析
 - 5.3.1 集成电路制造相关政策
 - 5.3.2 集成电路制造行业规模
 - 5.3.3 集成电路制造行业产量
 - 5.3.4 集成电路制造区域发展
 - 5.3.5 集成电路制造并购分析
 - 5.3.6 集成电路制程升级需求
 - 5.3.7 集成电路制造发展机遇
- 5.4 晶圆代工市场运行分析
 - 5.4.1 全球晶圆代工市场份额
 - 5.4.2 全球晶圆代工企业扩产
 - 5.4.3 全球专属晶圆代工厂排名
 - 5.4.4 国内本土晶圆代工公司排名
 - 5.4.5 晶圆代工市场发展预测

第六章 2021-2023年国外化学机械抛光（CMP）技术行业主要经营情况

- 6.1 美国应用材料
 - 6.1.1 企业发展概况
 - 6.1.2 2021年企业经营状况分析
 - 6.1.3 2022年企业经营状况分析
 - 6.1.4 2023年企业经营状况分析
- 6.2 荏原株式会社
 - 6.2.1 企业发展概况
 - 6.2.2 2021年企业经营状况分析
 - 6.2.3 2022年企业经营状况分析
 - 6.2.4 2023年企业经营状况分析
- 6.3 卡博特公司
 - 6.3.1 企业发展概况
 - 6.3.2 2021年企业经营状况分析
 - 6.3.3 2022年企业经营状况分析

6.3.4 2023年企业经营状况分析

6.4 陶氏公司

6.4.1 企业发展概况

6.4.2 2021年企业经营状况分析

6.4.3 2022年企业经营状况分析

6.4.4 2023年企业经营状况分析

第七章 2020-2023年国内化学机械抛光（CMP）技术行业主要企业经营情况

7.1 华海清科

7.1.1 企业发展概况

7.1.2 抛光垫产品发展

7.1.3 经营效益分析

7.1.4 业务经营分析

7.1.5 财务状况分析

7.1.6 核心竞争力分析

7.1.7 公司发展战略

7.1.8 未来前景展望

7.2 鼎龙股份

7.2.1 企业发展概况

7.2.2 抛光垫业务发展

7.2.3 抛光液业务发展

7.2.4 经营效益分析

7.2.5 业务经营分析

7.2.6 财务状况分析

7.2.7 核心竞争力分析

7.2.8 公司发展战略

7.2.9 未来前景展望

7.3 安集科技

7.3.1 企业发展概况

7.3.2 企业主要产品

7.3.3 经营效益分析

7.3.4 业务经营分析

- 7.3.5 财务状况分析
- 7.3.6 核心竞争力分析
- 7.3.7 公司发展战略
- 7.3.8 未来前景展望
- 7.4 天通股份
 - 7.4.1 企业发展概况
 - 7.4.2 企业主要业务
 - 7.4.3 经营效益分析
 - 7.4.4 业务经营分析
 - 7.4.5 财务状况分析
 - 7.4.6 核心竞争力分析
 - 7.4.7 公司发展战略
 - 7.4.8 未来前景展望

第八章 化学机械抛光（CMP）技术行业项目投资案例

- 8.1 CMP抛光材料投资项目案例
 - 8.1.1 项目建设内容
 - 8.1.2 项目投资必要性
 - 8.1.3 项目投资概算
 - 8.1.4 项目效益分析
- 8.2 CMP设备项目投资案例
 - 8.2.1 项目基本情况
 - 8.2.2 项目投资价值
 - 8.2.3 项目投资概算
 - 8.2.4 项目效益分析

第九章 对2024-2030年中国化学机械抛光（CMP）技术行业发展趋势及展望

- 9.1 CMP抛光材料行业发展趋势分析
 - 9.1.1 行业发展机遇
 - 9.1.2 产品发展趋势
 - 9.1.3 企业发展趋势
- 9.2 CMP设备行业发展趋势分析

- 9.2.1 行业面临机遇
- 9.2.2 行业发展前景
- 9.2.3 技术发展趋势
- 9.3 对2024-2030年中国CMP技术行业预测分析
 - 9.3.1 2024-2030年中国CMP技术行业影响因素分析
 - 9.3.2 2024-2030年中国CMP设备销售规模预测
 - 9.3.3 2024-2030年中国CMP材料市场规模预测

图表目录

- 图表 CMP工作原理示意图
- 图表 CMP反应原理示意图
- 图表 不同类型的CMP设备
- 图表 磨料机械去除原理示意图
- 图表 中国CMP技术行业相关支持政策
- 图表 电子化学品首批次应用示范指导目录
- 图表 2018-2022年国内生产总值及其增长速度
- 图表 2018-2022年三次产业增加值占国内生产总值比重
- 图表 2018-2022年货物进出口总额
- 图表 2022年货物进出口总额及其增长速度
- 图表 2022年主要商品出口数量、金额及其增长速度
- 图表 2022年主要商品进口数量、金额及其增长速度
- 图表 2022年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重
- 图表 2022年外商直接投资及其增长速度
- 图表 2022年对外非金融类直接投资额及其增长速度
- 图表 2018-2022年全部工业增加值及其增长速度
- 图表 2022年主要工业产品产量及其增长速度
- 图表 2023年全国规模以上工业增加值同比增长速度
- 图表 2023年全国规模以上工业生产主要数据
- 图表 2021年全国三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重
- 图表 2021年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度
- 图表 2021年固定资产投资新增主要生产与运营能力
- 图表 2022年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重

图表 2022年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度

图表 2022年固定资产投资新增主要生产与运营能力

图表 2023年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重

图表 2023年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度

图表 2023年固定资产投资新增主要生产与运营能力

图表 2020年全国居民人均可支配收入平均数与中位数

图表 2021年全国居民人均可支配收入平均数与中位数

图表 2018-2022年全国居民人均可支配收入及其增长速度

图表 2021年居民人均消费支出及构成

图表 2022年全国居民人均消费支出及其构成

图表 2023年居民人均消费支出及构成

图表 半导体材料主要细分产品

图表 半导体材料行业发展历程

图表 2015-2020年全球半导体材料市场规模

图表 2015-2020年全球半导体材料市场规模在半导体产业总规模占比

图表 2017-2020年中国半导体材料市场规模

图表 全球半导体材料市场构成

图表 抛光材料中抛光液占比约1/2

图表 CMP主要用在单晶硅片制造和前道制程环节

图表 CMP抛光材料行业产业链

图表 全球CMP各细分抛光材料市场份额

图表 全球抛光液市场格局

图表 全球抛光垫市场格局

图表 2014-2020年中国CMP抛光材料市场规模及增长率

图表 CMP抛光液的主要成分

图表 各类型抛光液主要应用领域

图表 2015-2021年中国半导体CMP抛光液市场规模及增速

图表 国内外CMP抛光液主要企业经营对比

图表 国产CMP厂商应对国产替代环境变化对比

图表 CMP抛光步骤随制程缩减而增加

图表 抛光垫分类

图表 不同制程芯片CMP抛光步骤数

图表 2016-2020年全球CMP抛光材料市场规模

图表 全球抛光垫厂商市场份额

图表 2022年全球半导体设备商营收排名

图表 2021年半导体各关键设备国产化率

图表 2020年全球CMP设备区域市场分布

图表 2020年全球CMP设备竞争格局

图表 2012-2020年全球CMP设备市场规模

图表 硅片制造过程CMP设备应用场景

图表 芯片制造过程CMP设备应用场景

图表 先进封装过程CMP设备应用场景

图表 2012-2020年全球CMP设备市场规模

图表 2013-2020年中国大陆CMP设备市场规模

图表 2020年全球CMP设备区域市场分布

图表 国内外CMP设备龙头企业对比

图表 集成电路制造行业发展历程

图表 2015-2021年全球集成电路市场规模

图表 2021年全球集成电路细分行业市场规模

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/412330.html>